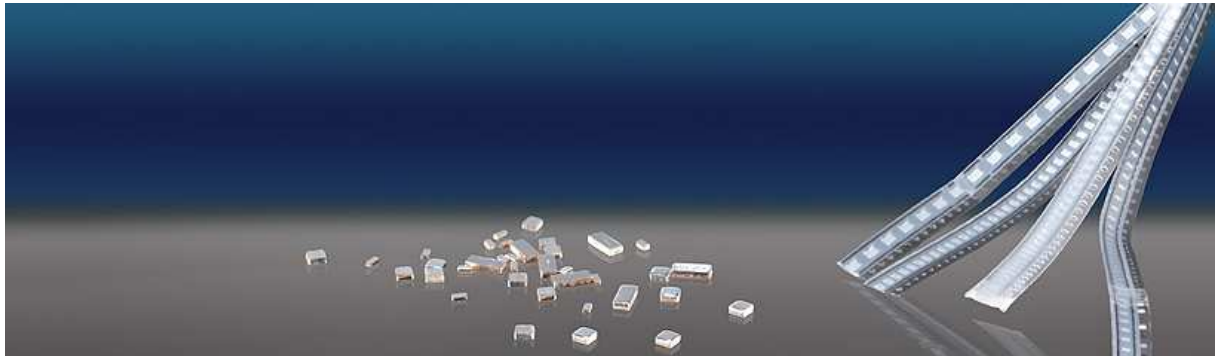


Heraeus AlSi:Pad



Klassische Bauelementeträger entwickeln sich immer stärker hin zum multifunktionalen Systemboard. Zunehmend komplexere Funktionalitäten müssen auf immer kleinerem Raum zusammengefasst werden bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit. Mit oberflächenbeschichteten Bondpads in verschiedenen Ausführungen bietet die W. C. Heraeus GmbH kundenorientierte Lösungsansätze.

■ Einsatzgebiete

- Leiterplatten
- Keramikhybride

■ Leistungsmerkmale

- Hohe Leitfähigkeit
 - Elektrische Leitfähigkeit 9,0 MS/m (für CuSn6)
 - Wärmeleitfähigkeit 75 W/mK (für CuSn6)
- Leichte und sichere Verarbeitbarkeit
- Hohe Robustheit
- Extended Shelf Life (ESL) garantiert lange Lagerfähigkeit
- Höchste Qualitätsstandards durch automatisierte Anlagentechnik und automatische 100% Kameraprüfung
- Verfügbar als RoHS konforme Version

Technische Eigenschaften

- Bondbar mit Al Dickdraht und AlSi Dünndraht
- Verfügbar für das Bonden mit Golddraht
- Lötbar mit bleifreien und bleihaltigen Loten
- Anwendbar auf allen lötbaren und klebbaren Oberflächen



Standardmaterialien

- 0,6 und 0,8 mm Dicke
- Trägerwerkstoff CuSn6



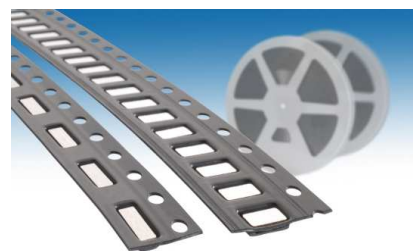
Funktionale Oberflächen

- Oberseite (Bondfläche): AlSi1, Ag
- Unterseite: Sn, SnPb10, CuSn6
 - Lötbar: Sn, SnPb10, CuSn6
 - Klebbar: Ag
- Weitere Materialien auf Anfrage



Standardabmessungen (LxB)

- 0,8 x 1,6 mm
- 1,8 x 1,8 mm
- 1,8 x 4,2 mm
- 2,0 x 2,0 mm
- 2,8 x 2,8 mm



Verpackung

- Verpackung nach DIN EN 60286-3
- Variable Gurtung möglich

Sonderlösungen auf Anfrage. Nutzen Sie unsere Anwendungsberatung!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

W. C. Heraeus GmbH
Engineered Materials Division
Packaging Technology
Heraeusstr. 12-14
63450 Hanau, Germany
Phone +49 (0) 6181.35-5644
packaging-technology@heraeus.com
www.bondpad.de